

MiTAC Computing Technology Corporation

04.06.2024 – 21:32 Uhr

Computing der nächsten Generation: MiTAC und TYAN präsentieren Server mit Intel® Xeon® 6 Prozessor für KI, HPC, Cloud und Enterprise Workloads auf der COMPUTEX 2024

Taipeh (ots/PRNewswire) -

MiTAC Computing Technology, die Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), und ihre Servermarke TYAN®, der weltweit führende Hersteller von Serverplattformen, stellen auf der COMPUTEX 2024, Stand M1120 in Taipeh, Taiwan, vom 4. bis 7. Juni ihre neuen Serversysteme und Motherboards vor, die für die heutigen KI-, HPC-, Cloud- und Unternehmens-Workloads optimiert sind. Diese Lösungen nutzen das Potenzial der neuesten [Intel® Xeon® 6 Prozessoren](#) und [Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 4. und 5. Generation](#), um Spitzenleistungen zu liefern.

„Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet MiTAC mit Intel an vorderster Front der Servertechnologie-Innovation und liefert kontinuierlich wegweisende Lösungen, die auf KI und High-Performance-Computing (HPC) zugeschnitten sind. Die Integration der neuesten Xeon 6-Prozessoren von Intel in unsere MiTAC- und TYAN-Serverplattformen transformiert die Rechenkapazitäten, erhöht die KI-Performance spürbar, steigert die Effizienz und skaliert den Cloud-Betrieb. Diese Weiterentwicklungen verschaffen unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch überlegene Leistung und optimierte Gesamtbetriebskosten“, so Rick Hwang, President der MiTAC Computing Technology Corporation.

Neue MiTAC/TYAN-Server mit Intel Xeon 6: bewährte Leistung und überragende Effizienz Intel® Xeon® 6 kommt in zwei Prozessorklassen auf den Markt, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Der Intel Xeon 6700 mit Efficient-Cores (E-Cores) verfügt über eine hohe Speicherbandbreite und umfangreiche E/A mit bis zu 8 DDR5-Kanälen, bis zu 64 Lanes CXL 2.0 und bis zu 88 Lanes PCIe 5.0. Er bietet eine hohe Kerndichte und eine außergewöhnliche Leistung pro Watt und damit signifikante Vorteile für Cloud-Workloads, die einen hohen Durchsatz erfordern. Mit ihrer außergewöhnlichen Speicherbandbreite und E/A überzeugen Performance-Cores (P-Cores) in einem breiten Spektrum von Workloads und bieten eine höhere KI-Leistung als andere CPUs. Darüber hinaus sorgen die integrierten Beschleuniger der P-Cores für eine zusätzliche Steigerung der Leistung und Effizienz bei bestimmten Workloads. E- und P-Cores verfügen über eine kompatible Architektur mit einem gemeinsamen Software-Stack und werden vom größten Ökosystem von Hardware- und Softwareanbietern unterstützt.

MiTAC präsentiert zwei [neue Dual-Socket-Serverplattformen mit Intel® Xeon® 6 Prozessoren](#). Der auf HPC- und KI-Workloads zugeschnittene TX86-E7148 (Codename „Katmai Pass“) ist das Nachfolgemodell der [Intel Server D50DNP-Familie](#), die bis zu vier Rechenmodule in einem 2-HE-Gehäuse aufnehmen kann und sowohl Luft- als auch Flüssigkeitskühlung für unterschiedliche Infrastrukturen unterstützt. TX77A-E7142 (Codename „Deer Creek Pass“), das Nachfolgemodell der [Intel Server M50FCP-Familie](#), ist eine voll ausgestattete, leistungsoptimierte Plattform für datenintensive Anwendungen.

TYAN stellt auf der COMPUTEX drei [Intel® Xeon® 6-basierte Serverprodukte](#) vor. Den Anfang macht der Thunder HX FT83B-B7149 – eine 4U-Dual-Socket-Serverplattform, die für massiv-parallele KI- und HPC-Workloads entwickelt wurde. Mit 32 DDR5 RDIMM-Steckplätzen und bis zu 8 PCIe 5.0 x16-Steckplätzen mit doppelter Breite ist der FT83B-B7149 eine leistungsstarke Plattform für rechenintensive KI- und HPC-Anwendungen. Der nächste ist der Thunder CX GC73A-B5660, ein 1U-Single-Socket-Server, der 12 Hot-Swap-NVMe-U.2-Laufwerksschächte, 2 Standard-PCIe 5.0 x16- und 2 OCP 3.0-Mezzanine-Steckplätze für On-Prem-Edge-Computer-/Speicheranwendungen bietet. Schließlich präsentiert TYAN den Tempest HX S5662, ein Single-Socket-Motherboard für KI-Server im Standard-CEB-Formfaktor, das für den Einsatz mehrerer GPU-Karten ausgelegt ist. Es unterstützt 8 DDR5 RDIMM-Steckplätze, 5 PCIe 5.0 x16-Steckplätze, 2 NVMe M.2-Steckplätze, duale 25-GbE- und einen GbE-Port.

Serverplattformen mit Gen Intel® Xeon® Scalable Prozessor der 4. und 5. Generation mit Blick auf die wachsenden Anforderungen von KI, HPC und Cloud Im Juli 2023 übertrug Intel an MiTAC die Rechte zur Herstellung und zum Vertrieb von Produkten, die auf den Designs der Intel Data Center Solution Group (DSG) basieren. Seitdem tätigt MiTAC kontinuierliche Investitionen in die DSG-Produktpalette und deren Unterstützung. In diesem Jahr enthüllt MiTAC auf der COMPUTEX 2024 seine [DSG-Produkte](#). Die [Intel Server D50DNP-Familie](#), die auf Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. und 5. Generation oder der Intel Xeon CPU Max-Serie basieren,

bietet eine außergewöhnliche Rechenleistung, zusammen mit einer effektiveren Beschleunigung von KI-Funktionen und In-Memory-Analysen, die in den Prozessor integriert ist. Die [Intel Server M50FCP-Familie](#) liefert unterdessen eine hervorragende Rechenleistung, Hochgeschwindigkeits-E/A und Speicherdurchsatz für die meisten Standard-Serveranwendungen.

Ferner hat TYAN [eine Reihe von Produkten im Angebot, die Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. und 5. Generation unterstützen](#). Für KI-Server am Schreibtisch stellt TYAN den [Thunder HX FT65T-B5652](#) vor – eine Rack-konvertierbare Single-Socket-Serverplattform, die für den Einsatz von bis zu 4 Double-Slot-GPU-Karten ausgelegt ist.

TYAN stellt verschiedene Arten von Density-Servern für unterschiedliche Workload-Anforderungen in platzbeschränkten Rechenzentren bereit. Der [Thunder CX TD76-B5658](#) ist ein 2U-Gehäuse, das 4 Single-Socket-Serverknoten für High-Density-Computing-Anforderungen beherbergt; [Thunder CX GC68A-B7136](#) ist eine 1U-Dual-Socket-Server-Implementierung mit 16 DDR5 RDIMM-Steckplätzen und hybrider Speicherkonfiguration; [Thunder CX GC79A-B7132](#), ein weiterer 1U-Dual-Socket-Server, bietet bis zu 32 DDR5 RDIMM-Steckplätze und eine All-Flash-Konfiguration.

Für Mainstream-2U-Dual-Socket-Speicherserver sind mit [Thunder HX TS75A-B7132](#) und [Thunder SX TS70A-B7136](#) zwei Plattformen verfügbar, die hohe Daten-IOPs mit hybriden 2,5-Zoll-Laufwerkskonfigurationen bieten, während [Thunder SX TS70-B7136](#) mit ihren 12 3,5-Zoll-Hybrid-Laufwerksschächten eine alternative Implementierung für höhere Speicherkapazitätsanforderungen darstellt. Für die Speicherung kalter Daten wird [Thunder SX TX88-B5652](#) empfohlen, ein Single-Socket Storage Server mit 24 3,5-Zoll-SATA und 2 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerkseinschüben mit Hot-Swap-Funktion und werkzeuglosem Zugriff.

Außer den Serversystemen präsentiert TYAN an seinem Stand auch seine standardkonformen Motherboards mit Intel® Xeon® CPUs der 4. und 5. Generation. Die präsentierten Produkte sind [Tempest HX S5652](#) – ein KI-Server-Board, das für den Einsatz mehrerer GPU-Karten im CEB-Formfaktor ausgelegt ist, und [Tempest HX S7130](#), ein Mainstream-Dual-Socket-Board, das 5 PCIe 5.0-Steckplätze im EEB-Formfaktor unterstützt.

Neben den genannten Produkten bieten MiTAC und TYAN weitere Lösungen für vielfältige Anforderungen an. Eine dieser Lösungen ist der TYAN Thunder CX GX40-B5573, ausgestattet mit [Intel Xeon E-2400-Prozessoren](#), der für Cloud- und On-Premise-Computing geeignet ist. Dieses 1U-Single-Socket-Serversystem ist für kosteneffizientes Edge Computing konzipiert und stellt eine ideale Option für kleine Unternehmen dar. Zudem stellt MiTAC einen ORAN DU-Server vor: den [WS1S11](#) (Whitestone2). Dieser DU-Server unterstützt Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 4. Generation mit Intel® vRAN boost und verfügt über IEEE1588-Zeitsynchronisation, synchrones Ethernet, Onboard NIC für ORAN FH/MH und einen dualen -48-VDC-Stromeingang.

Informationen zu MiTAC Computing Technology Corp. MiTAC Computing Technology Corp, eine MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ist auf Cloud- und Edge-Computing-Lösungen spezialisiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung. Mit einem starken Fokus auf große Rechenzentren bietet das Unternehmen flexible und maßgeschneiderte Versorgungsmodelle für verschiedene Systeme und Anwendungen. Die Produktpalette umfasst TYAN-Server, ORAN-Server, Hochleistungs-KI-Server und Produkte für Rechenzentren. Die Intel Datacenter Solutions Group (DSG) hat ihr Geschäft seit Juli 2023 auf MiTAC übertragen, wodurch MiTAC sein Produktangebot um innovative Lösungen für die Gesamtbetriebskosten für die Rechenzentrumsausrüstung der nächsten Generation erweitern kann.

MiTAC Computing Technology Corporation Website: www.mitacmct.com

Website von MiTAC DSG: <https://datacentersolutions.mitacmct.com/>

Informationen zu TYAN TYAN ist eine führende Servermarke der MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706). Sie entwickelt, fertigt und vermarktet fortschrittliche x86- und x86-64-Server-/Workstation-Board-Technologie, Plattformen und Serverlösungsprodukte. Die Produkte von TYAN werden an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Reseller weltweit für eine große Bandbreite von Anwendungen vertrieben. Mit seinen skalierbaren, hochgradig integrierten und zuverlässigen Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen wie Server-Appliances, Lösungen für HPC oder Hyperscale-Rechenzentren unterstützt TYAN seine Kunden auf ihrem Weg zur Führung im Bereich Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von TYAN unter <http://www.tyan.com> oder auf der Website der MiTAC Computing Technology Corporation unter <http://www.mitacmct.com>

Intel, das Intel-Logo und andere Marken sind Handelszeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2427739/2024_Computex_Intel_PR.jpg

View original content: <https://www.prnewswire.com/news-releases/computing-der-nachsten-generation-mitac-und-tyan-prasentieren-server-mit-intel-xeon-6-prozessor-fur-ki-hpc-cloud-und-enterprise-workloads-auf-der-computex-2024-302163813.html>

Pressekontakt:

Veronica Wu,
veronica.wu@tyan.com.tw; MiTAC Computing Technology Corp. / Server Infrastructure BU,
Marketing@mitacmct.com

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100090544/100920127> abgerufen werden.